附件2：需求范围

1、设备需求：检验检测、集成电路半导体产线用设备，包括前道工艺设备和后道工艺设备等；封装及材料用设备、测试测量设备，包括矢量网络分析仪等；通用类装备维修、发动机零部件检测设备、计量设备等；

2、材料需求：半导体材料，集成电路产线用特殊气体、微组装用材料等；金属、配件包装类材料，化工原料等；

3、技术需求：橡胶材料成分检测技术、金属零部件寿命预测分析技术、结构无损检测技术等；（老旧）电器件、液压元器件的先进修复技术等；自控仪表类技术支持；化学试剂合成及改进技术等；

4、配件需求：通讯设备、汽车、电子设备、液压设备元器件及维修配件；配液、供料系统，空调、净化系统配件等；

5、装备维修保障需求：半导体、封装、微波射频等专用设备仪器维修；机械制造类、进口装备、检验检测类设备维修；车辆检测设备、维修工具；

6、服务外包类需求：生产服务人员，检测、维修、加工、运输、仓储等；

7、数字化产业升级需求：智慧厂区建设、数字车间、技术改造、基于现代化企业管理的信息系统、大数据分析等。